

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung in die Halbleiter-Physik	1
1.1 Bandstrukturen	1
1.2 Halbleiter und Isolatoren	3
1.2.1 Das Löchermodell	7
1.3 Silizium	7
1.3.1 Reines Silizium	7
1.3.2 Dotiertes Silizium	9
1.4 Der gestörte Halbleiter	14
1.4.1 Drift und Diffusion	15
1.4.2 Generations- und Rekombinationsstatistik	18
1.4.3 Zustandsgleichungen	19
1.5 Wichtige Formeln	23
2 Inhomogene Halbleiter	24
2.1 Der pn-Übergang	24
2.2 pn-Übergang mit Vorspannung	31
2.3 Spannungs- und Stromcharakteristik der Diode	35
2.4 Wichtige Formeln	42
3 Der MOS-Kondensator	44
3.1 Die Schwellenspannung	45
3.2 Einfache Theorie des MOS-Kondensators	47
3.3 Ergänzungen zur Theorie des MOS-Kondensators	51
3.3.1 Austrittsarbeitsdifferenz	51
3.3.2 Oxidladungen	54
3.3.3 Oberflächenzustände	55
3.3.4 Durchführung und Auswertung von C(U)-Messungen	57
3.4 Wichtige Formeln	58
4 MOS-Transistor	59
4.1 Das einfachste MOS-Transistormodell	59
4.2 Der PMOS-Transistor	68
4.3 Ergänzungen zum einfachen MOS-Modell	71

4.3.1	Die Querfeldbeweglichkeitsreduktion	71
4.3.2	Der Substrateffekt	72
4.3.3	Die schwache Inversion	73
4.3.4	Durchbruchseffekte	74
4.3.5	Latchup	78
4.4	Feinstruktureffekte	80
4.4.1	Kurzkanaleffekt	81
4.4.2	Hot-Electron-Effect	82
4.5	Spezielle MOS-Strukturen	84
4.5.1	Depletion-Transistoren	84
4.5.2	Spannungsfeste MOS-Transistoren	85
4.5.3	Programmierbare MOS-Transistoren	88
4.5.4	Charge-Coupled-Device	90
4.6	Wichtige Formeln:	92
5	CMOS-Technologie	95
5.1	Einleitung	95
5.1.1	Isolation	95
5.2	Grundlegende Fertigungsschritte	96
5.2.1	Fotolithographie	97
5.2.2	Ionenimplantation	106
5.2.3	Diffusion	108
5.2.4	Schichterzeugung	113
5.2.5	Schichtstrukturierung	125
5.2.6	Reinigungsprozesse	129
5.3	Halbleiter-Prozesse	131
5.3.1	Ein hypothetischer CMOS-Prozess	131
5.3.2	Prozessergänzungen	143
6	Der Inverter	151
6.1	Last- und Schaltelemente, Grundfunktionen	151
6.1.1	Inverter mit ohmscher Last	153
6.1.2	Inverter mit Enhancement-Last	156
6.1.3	Inverter mit Depletion-Last	162
6.1.4	Der CMOS-Inverter	164
6.1.5	Störfestigkeit	167
6.1.6	Vergleich der Invertertypen	168
6.2	Dynamisches Verhalten von MOS-Invertern	169
6.2.1	Entladung (Abfallzeit)	170
6.2.2	Aufladung über eine Depletion-Last (Anstiegszeit)	173
6.2.3	Anstiegszeit des CMOS-Inverters	176
7	Verstärker, Treiber und Gatter	180
7.1	Verstärker	180
7.2	Treiberschaltungen	181

7.3 Logische Gatter	184
7.4 Komplex-Gatter	186
7.5 Dynamische Gatter	192
8 Flip-Flops, RAM und ROM	196
8.1 Flip-Flops	196
8.2 Speicher, RAM und ROM	197
9 Ein- und Ausgangsschaltungen	202
9.1 Ausgangstreiber	202
9.2 Eingangsschaltungen	204
10 Entwurfsunterlagen	215
10.1 Design-Regeln	215
10.2 Elektrische Entwurfsunterlagen	220
10.3 Teststrukturen	222
11 Entwurfswerkzeuge	224
11.1 Grafische Editoren	224
11.2 Simulatoren	227
11.2.1 Prozesssimulatoren	229
11.2.2 Devicesimulation	232
11.2.3 Schaltungs-Simulatoren (analog)	234
11.2.4 Digital-Simulatoren	240
11.2.5 Hardware Beschreibungssprachen	246
11.3 Hilfsprogramme	248
11.3.1 Plazierung und Verdrahtung	248
11.3.2 Überprüfungsprogramme	249
12 Entwurfssystematik	251
12.1 Entwurfsstrategien	252
12.1.1 Der Standardzellen-Entwurf	253
12.1.2 Der Gate-Array-Entwurf	253
Literatur zur CMOS-Technologie	259
Formelzeichen und Abkürzungen	262
Physikalische Konstanten	264
Index	265